

<2020年度『市場・業界及び技術動向セミナー』開催要領>

1. 開催日時：2020年11月17日（火）13:30～16:50（受付開始13:00）
2. 会場： Zoomによるオンライン開催
3. 主催： 一般社団法人 日本半導体商社協会(DAFS) セミナー委員会  
後援： 経済産業省（予定）、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、  
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)
4. 演題・講師／略歴・講演要旨：

<DAFS セミナー委員長ご挨拶：13:30～13:35>

・第1部（13:35～15:05）（90分）

演題： 「ものづくり現場の現実に対応した AI や IoT 活用の実際」

講師： 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
センシングシステム研究センター 副研究センター長  
山下 健一 氏

講演要旨

データがなければ AI は動かないが、初めから AI がフル活用できるほどデータもないというパラドックスを解決するために取り組んだ研究開発の例を紹介する。IoT と言いながらバラバラに集められたデータを活用するためには、互いの紐づけが必要であり、この理想と現実のギャップへの対応などを紹介する

講師略歴

2002年3月 九州大学大学院工学府化学システム工学専攻博士課程修了・博士（工学）  
2002年4月 独立行政法人産業技術総合研究所へ研究職員として採用  
以降、研究員、主任研究員、企画主幹、研究グループ長などの役職を経て、現在、センシングシステム研究センター 副研究センター長

（休憩：15分）

・第2部（15:20～16:50）（90分）

演題： 『AI・IoT 社会へ貢献する 3次元集積実装技術と国家プロジェクトにおける研究開発動向』

講師： 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
3D集積システムグループ 研究グループ長  
菊地 克弥 氏

## 講演要旨

近年の AI・IoT 社会に必要な電子デバイスでは、小型化、低消費電力化、高性能化が要求されている。そのため、シリコン貫通電極(TSV)を用いて半導体デバイスを縦方向に積層する 3次元集積実装技術は、メモリ積層のような単一機能のデバイスの 3次元集積のみならず、メモリやロジックなどの複数機能を 3次元集積する応用が期待されている。今回は、AI・IoT 社会のさらなる発展に向けて、車載半導体、ビッグデータ処理などへの応用を想定した 3次元集積実装技術の研究開発とその国家プロジェクトについて紹介する。

## 講師略歴

2001年埼玉大学大学院博士後期課程情報数理科学専攻修了。博士(工学)。

同年、産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門高密度 SI グループ勤務。

以降、半導体 LSI 実装技術における 3次元集積実装技術をはじめとする次世代の電子回路高密度実装技術、超高速・高周波回路実装技術、およびその計測・評価技術の研究開発等に従事。

2015年同ナノエレクトロニクス研究部門 3D 集積システムグループ、研究グループ長。

2020年同デバイス技術研究部門 3D 集積システムグループ、研究グループ長。

現在は、半導体 LSI 実装技術における 3次元集積実装技術に加え、超伝導量子デバイスの 3次元集積実装技術の研究開発に従事。

5. 受講対象者：DAFS 会員及び関連団体会員 (JEITA、NEDIA、SSIS 等)、その他エレクトロニクス分野の業務に従事されている方、または同分野に関心をお持ちの方であればどなたでも受講可能です。
6. 参加費 (非会員)： 14,300 円 / 1 人 (消費税込み、別途請求書発行)
7. 受講申し込み：[dafs@dafs.or.jp](mailto:dafs@dafs.or.jp) までメールでお申し込みください。

申し込み締め切りは 10 月 30 日 (金) といたしますが、定員 (50 名) に達し次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

以上